

公司代码：688484

公司简称：南芯科技

# 上海南芯半导体科技股份有限公司

## 2023 年年度报告摘要

## 第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 网站仔细阅读年度报告全文。

### 2 重大风险提示

公司已在本报告中详细描述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“四、风险因素”中相关内容。

3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

4 公司全体董事出席董事会会议。

5 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6 公司上市时未盈利且尚未实现盈利

是 否

7 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司 2023 年度利润分配预案为：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基准向全体股东每 10 股派发现金红利 2.8 元（含税），截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 42,353 万股，以此计算合计拟派发现金红利 118,588,400 元（含税）。

公司 2023 年度利润分配预案已经公司第一届董事会第二十二次会议及第一届监事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

8 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

适用 不适用

## 第二节 公司基本情况

### 1 公司简介

#### 公司股票简况

适用 不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	南芯科技	688484	不适用

#### 公司存托凭证简况

适用 不适用

#### 联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书（信息披露境内代表）	证券事务代表
姓名	梁映珍	王蓉
办公地址	中国（上海）自由贸易试验区盛夏路565弄54号（4幢）1601	中国（上海）自由贸易试验区盛夏路565弄54号（4幢）1601
电话	021-50182236	021-50182236
电子信箱	investors@southchip.com	investors@southchip.com

### 2 报告期公司主要业务简介

#### (一) 主要业务、主要产品或服务情况

南芯科技是国内领先的模拟和嵌入式芯片设计企业之一，主营业务为模拟与嵌入式芯片的研发、设计和销售，专注于电源及电池管理领域，为客户提供端到端的完整解决方案。公司现有产品已覆盖移动设备电源管理芯片（含有线充电管理芯片、无线充电管理芯片、锂电管理芯片、其他移动设备电源管理芯片）、通用电源管理芯片、适配器电源管理芯片、汽车电子芯片通过打造完整的产品矩阵，满足客户系统应用需求。公司产品主要应用于手机、笔记本/平板电脑、电源适配器、智能穿戴设备等消费电子领域，储能电源、电动工具等工业领域及车载领域，部分终端应用情况如下：



智能手机



笔记本电脑



平板电脑



适配器



智能穿戴设备及  
消费配件



无线充电



无人机、机器人



储能电源



电动工具



车载充电

公司主要产品情况如下：

产品类别		产品介绍
移动设备电源管理芯片	有线充电管理芯片	采用降压/升压斩波/开关电容等拓扑进行电压电流的转换控制，支持从 10W 到 300W 的充电功率。产品支持单串到多串的电池供电系统，并且包括多串电池升降压的充放电管理。
	无线充电管理芯片	利用电磁感应原理，在没有实体电线连接的情况下，通过控制初级和次级线圈感应产生的电流，将能量从发射端无接触传输到接收端，并通过无线通信协议对传输能量进行控制，从而为用电设备进行安全充电
	锂电管理芯片	实现对锂电池电芯充放电状态的监测和保护，对电量进行管理，避免电芯出现过充、过放、温度过高等异常情况，提高电芯性能和使用寿命
	其他移动设备电源管理芯片	
通用电源管理芯片	通用电源管理芯片	包括开关充电芯片和线性充电芯片，对单节和多节锂电池进行充电管理，广泛应用在各种消费和工业市场领域，为便携式设备进行充电
适配器电源管理芯片	AC-DC 芯片	实现交流电向直流电的转换。通过整流控制器将工频交流电转换为脉动直流电，再通过滤波电路将脉动直流中的交流成分滤除，减少交流成分，增加直流成分，并通过负反馈系统控制，对整流后的直流电压进一步进行调制和稳压
	协议芯片	实现充电器和终端用电设备之间就各自 USB 端口所支持的快充协议、充电能力和所需充电功率进行通讯，并进行相应的快充申请和控制，实时传递充电状态信息，进行 USB 端口充电状态监测和保护，是快充得以实现的基础
	其他适配器电源管理芯片	

汽车电子芯片	DC-DC 芯片	通过高频、周期性控制电力电子开关器件的开关，将输入直流电压转换为另一个直流电压，并通过负反馈系统控制，实现输出电压调整稳压的功能，广泛应用于消费、工业和汽车等各领域
	其他汽车电子芯片	

公司以“成为全球领先的模拟与嵌入式芯片企业”为经营愿景，凭借高效的研发能力、卓越的技术创新能力以及严苛的品质管控能力，在消费电子、工业及汽车电子领域推出高性能电源及电池管理芯片，助力国产芯片自主可控。公司与上游晶圆制造商、封装测试厂商等供应商建立了高效的联动机制和长期稳定的合作关系，提高了公司的供应链能力；公司与终端品牌客户建立了日益紧密的伙伴关系，在良好的合作中及时了解需求端技术新方向、新动态，针对性地对产品进行研发迭代，从而提高研发效率。未来，公司将继续加强技术积淀，加大研发投入，持续对现有产品进行迭代升级，不断丰富产品矩阵，提升在消费电子领域的优势，进一步拓展在工业和汽车电子领域的应用，致力于成为全球领先的模拟与嵌入式芯片企业。

## (二) 主要经营模式

报告期内，公司经营模式无重大变化。公司采用的经营模式为行业同行的 Fabless 模式，主要专注于芯片的设计与销售，将晶圆制造、封装、测试等生产环节外包给第三方晶圆制造和封装测试企业完成。

### 1、研发模式

公司采用 Fabless 的经营模式，产品设计及研发是公司业务的核心。公司高度重视研发创新体制的建设与管理，长期致力于建立规范化的产品研发流程及质量控制体系，确保各产品系列在研发的各个阶段均能够实现优质的产品、有效的质量保障及可靠的风险管理。公司具体研发流程包括立项阶段、项目设计阶段、产品验证及量产阶段等业务流程，确保产品的研发和验证过程都得以有效的控制和管理。

### 2、采购及生产模式

公司专注于芯片的研发和销售，通过委托晶圆厂和封测厂外协加工完成晶圆制造和封装测试，公司自身仅从事部分芯片的测试工作。该模式具有技术驱动，灵活高效等特点。

在 Fabless 模式中，公司主要进行芯片产品的研发、销售与质量管控，产品的生产则采用委外加工的模式完成，即公司将自主研发设计的集成电路数据交由晶圆厂进行晶圆制造，随后将制造完成的晶圆交由封测厂进行封装和测试。目前，公司采购的内容主要为晶圆和其相关的封装及测试服务，公司的晶圆代工厂商和封装测试服务供应商主要为行业知名企业。

### 3、销售模式

公司目前采用“经销为主，直销为辅”的销售模式，即公司既通过经销商销售产品，又向终端厂商直接销售产品。直销模式是指公司将产品销售给终端客户，经销模式是指公司将产品买断性地销售给经销商。

### (三) 所处行业情况

#### 1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

##### 1、所属行业

公司主营业务为模拟与嵌入式芯片的研发、设计和销售，所处行业属于集成电路设计行业。根据《中华人民共和国国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》，公司所属行业为“制造业”中的“计算机、通信和其他电子设备制造业”，行业代码为“C39”。公司所处的集成电路设计行业属于国家发改委颁布的《产业结构调整指导目录（2019年本）》所规定的鼓励类产业，政府主管部门为工信部，行业自律性组织为中国半导体行业协会。

##### 2、行业发展概况

###### (1) 集成电路行业

集成电路行业是信息技术产业的核心，是支撑经济社会发展和保障国家安全的战略性、基础性和先导性产业。集成电路产品根据功能主要可分为数字芯片和模拟芯片，其中数字芯片指基于数字逻辑设计和运行的，用于处理数字信号的集成电路芯片，包括微元件、存储器 and 逻辑芯片适配器电源管理芯片；模拟芯片指处理连续性模拟信号的集成电路芯片。

由于2023年的第二季度和第三季度市场表现略好于之前预期，2023年11月底，世界半导体贸易统计组织（WSTS）上调了2023年全球半导体市场规模的预测，从此前的5,150亿美元调整至5,201亿美元，2023年全球半导体市场较2022年同比下降9.4%。

根据WSTS预测，2024年全球各地区半导体市场都将有所回暖，特别是美洲和亚太地区，将实现两位数以上的增长。预计2024年全球半导体市场将实现强劲复苏，预测增长13.1%至5,884亿美元。

长期来看，全球及中国集成电路产业仍将持续增长。近年来蓬勃发展的新能源车、5G、自动驾驶、数据中心、工业自动化、人工智能、物联网、可穿戴设备等新兴产业将形成强大的未来需求。未来几年通信、消费电子、数据中心等领域成长率减缓，而车用和工业用领域成长较快。

我国是全球最大的集成电路需求市场，特别是对价值较高的高端芯片进口依赖仍较大，芯片进口金额远超出口金额，显示我国在芯片领域存在大量的进口替代空间。我国高端集成电路产业实现自主可控、进口替代，成为了亟待解决的问题。为推动芯片国产化进程，2015年5月，国务院发布《中国制造2025》提出2025年芯片自给率要达到70%的发展目标。

根据国家统计局发布的2023年国民经济和社会发展统计公报，我国2023年全年集成电路产量3,514.4亿块，比上年提升6.9%；全年集成电路出口2,678亿个，比上年下降1.8%，金额为9,568亿元，比上年下降5.0%，在我国主要商品出口中金额排名第四；集成电路进口4,796亿个，比上年下降10.8%，金额为24,591亿元，比上年下降10.6%，在我国主要商品进口中金额排名第一。

###### (2) 模拟芯片行业

模拟集成电路产品的生命周期较长，下游应用广泛且分散，是整个市场发展的晴雨表。得益于行业本身的技术积累和消费电子、智能家居、智能安防、汽车电子、工业控制等下游应用领域的发展，模拟集成电路行业保持稳定发展。根据WSTS预测，全球模拟芯片2024年市场规模将实

现 841 亿美元，较 2023 年同比增长 3.7%。

2023 年，中国模拟芯片市场增速有所放缓，但预计规模将超过 3000 亿元人民币，占全球模拟芯片市场规模 50% 以上，中短期内中国仍将是全球最大的模拟芯片消费市场。

随着国内汽车、工业、通信等领域对模拟芯片的应用需求拉动，以及国产模拟芯片有较大国产化率的提升空间，未来中国模拟芯片市场将持续增长。

### 3、行业技术水平及特点

在大功率充电方面，以手机为代表的消费终端充电功率逐步提升，常规的 18W 充电功率已逐步被 33W 取代，部分高端机型、旗舰机型已推出 200W 及以上充电功率，带动大功率充电的渗透率和充电功率持续提升。

在小型化充电方面，第三代半导体技术和高集成度方案使得适配器功率密度提升，外围器件减少，小型化充电方案成为市场趋势。

在端到端完整解决方案方面，完整解决方案能够降低终端厂商系统成本，减少终端厂商产品开发周期。对芯片厂商来说，提供端到端完整解决方案需要芯片厂商对整个系统有充分的理解，突破单款产品研发的局限，对芯片厂商的要求较高。

### 4、主要技术门槛

公司产品下游应用包括手机、笔记本电脑等高端消费领域，汽车及工业领域。其中手机内部电源管理芯片因对其体积、稳定性、一致性要求较高，且公司产品主要用于充电管理及电池管理，对安全及性能要求较高；汽车及工业级应用场景对芯片要求较高。因此，公司所处行业存在较高的技术壁垒。

## 2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

(1) 公司是国内少数在细分领域能与同行业国际大厂直接竞争并实现高端产品国产替代的公司之一

全球拥有突出研发实力和规模化运营能力的模拟与嵌入式芯片公司主要集中在海外，南芯科技是国内在电源及电池管理领域少数能与国际大厂直接竞争并实现高端产品国产替代的公司之一。在手机等消费电子应用领域，公司直接与同行业国际大厂竞争，并取代了部分国际大厂市场份额，助力芯片国产替代。在以充电管理芯片为代表的产品中，公司部分型号的关键技术指标已具备了与国际大厂相竞争的性能或超越国外竞品的性能。

(2) 公司是国产模拟芯片领域的中坚力量

经过多年发展，公司已经跻身国产模拟芯片设计公司前列，成长为国产模拟芯片领域的中坚力量。公司作为专注于电源管理芯片的设计公司，产品覆盖了整个充电链路环节，是少数具备供电端到设备端完整解决方案的本土企业。公司在智能手机、汽车电子、工业和泛消费等领域，打通整个产品应用领域，产品矩阵丰富，完成各应用场景的端到端产品布局，加强公司整体的产品创新竞争力。公司凭借前瞻的产品定义能力和强大的研发能力，产品具有性能领先和高可靠性等优势，在智能手机、汽车电子、工业和泛消费等领域获得客户广泛的认可。在智能手机领域，公司产品已进入荣耀、OPPO、小米、vivo、传音等知名手机品牌；在汽车领域，公司产品已进入沃

尔沃、现代等品牌；在工业领域，公司产品已进入 TTI 等品牌；在泛消费领域，公司产品已进入 Anker、紫米、贝尔金、哈曼等品牌。

### 3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

#### 1、新技术

##### (1) 高效低耗化

在电源领域，电能转换效率和待机功耗始终是核心指标之一。世界各国都推出了各类能效标准，例如美国的能源之星、德国的“蓝天使标准”、中国中标认证中心等。业界通过研发更先进的电路拓扑和开关控制技术、更低导阻的功率器件技术、更精巧的高压启动技术等实现电源管理芯片及其电源系统的高效率和低功耗要求。

##### (2) 集成化

便携式设备的轻薄化始终是提升用户体验的重点需求，电源及电池管理芯片技术也表现出越来越显著的集成化趋势。一方面，终端产品为实现轻薄化目标，要求芯片具有更高的集成度、更少的外围器件，以降低整个方案元器件数量，节约电路板空间，缩小整个方案尺寸；另一方面，终端设备正变得越来越复杂，其更多功能特性、所使用更复杂的处理器等，都需要更先进的电源管理解决方案，要求在更小的硅芯片上集成更多功能，实现更强的系统用电性能。同时，集成化的电源及电池管理芯片可以有效降低系统成本和设计复杂性，缩短终端厂商的研发周期，同时提高系统的长期可靠性。

##### (3) 模拟技术和嵌入式处理技术相互协同

随着系统功能越来越复杂，对能耗的要求越来越高，系统对电源和电池运行状态监测与控制的要求也越来越高。电源和电池管理芯片设计不再满足于实时监控电流、电压、温度，还需要实现诊断电源供应情况、电池工作状态、灵活设定输出电压电流参数等要求。此外，电源管理芯片在满足系统各功能模块供电需求的同时，也越来越多地需要和主系统之间进行实时通讯，以满足智能化的功率管理和调控需求。模拟技术和嵌入式技术相互协同，促进了电源和电池管理芯片向智能化方向发展。通过硬件和嵌入式软件的无缝结合，可以灵活实现对电源和电池状态的监测、控制、通讯等功能。近年来凭借调试灵活、响应快速、高集成度以及高度可控的优势，以模拟技术和嵌入式处理技术相结合的新一代电源和电池管理芯片正逐步拓展至多个应用领域。

#### 2、新产业

##### (1) 第三代化合物半导体氮化镓（GaN）成为市场趋势

充电器中体积占比最大的器件为变压器，充电器小型化的关键在于变压器的小型化。通常开关频率越高，所需的变压器体积越小。传统 Si 材料的开关频率已达上限，第三代半导体材料可以实现更快的开关速度，因此允许更高的开关频率，进一步缩小充电器的体积。凭借开关速度快、功率密度高、耐高压、高频等特点，基于 GaN 第三代化合物半导体小体积充电适配器在高端机型的应用日益广泛。根据 Yole 的数据，功率 GaN 在消费市场的应用规模，预计将从 2021 年的 7,960 万美元增长到 2027 年的 9.647 亿美元，年复合增长率达 52%。

在 GaN 电源市场不断拓展的过程中，对芯片的集成度要求也越来越高。最初的 GaN 电源电源一般采用控制器+驱动+氮化镓功率器件进行组合设计，不仅电路布局较为复杂，产品开发难度相对较大，而且成本也较高。近年来行业优秀芯片厂商基于其电源芯片的技术优势，推出了内置 GaN

功率器件的高集成电源芯片，即合封 GaN 芯片。通过提高芯片集成度，进一步减少了外围元件、缩小了充电器体积，同时也降低了系统开发调试难度，提高了产品可靠性。

#### （2）智能化和电动化驱动汽车电子快速发展

智能化电动化变革正在重塑传统汽车产业链格局，汽车电子成为推动变革的核心要素，各类模拟和嵌入式芯片、传感器、计算芯片在电动智能车各功能模块广泛使用，驱动汽车电子快速发展，汽车电子供应链价值快速提升。根据罗兰贝格预测，2019 年-2025 年汽车电子相关的 BOM（物料清单）价值量将从 3,130 美元/车提升到 7,030 美元/车，其中智能化 BOM 价值量提升 1,665 美元/车，电动化 BOM 价值量提升 2,235 美元/车。

在电源及电池管理芯片领域，得益于自动驾驶和智能驾驶舱等智能化功能在汽车上的广泛应用，与数字化显示、人车交互及 ADAS 相关的芯片，如显示屏电源、背光驱动、USB 车载充电、系统及摄像头供电等需求大幅增加。电动化变革下，传统燃油动力总成系统被淘汰，电动动力总成系统采用了 BMS、DC-DC 转换器等新型部件，电源及电池管理芯片需求大增。汽车电子成为继消费领域之后，推动电源和电池管理芯片市场快速增长的另一领域。

### 3、新业态

#### （1）各个国家或地区政府加大对产业的支持力度

近年来由于多个国家遭受芯片短缺，包括美、日、欧洲在内的集成电路制造强国和地区重新认识到集成电路技术领先和供应安全的重要性，纷纷出台支持性政策，加速布局包含集成电路在内的半导体产业，并强化政府对产业的支持力度，巩固企业的竞争力。以欧洲为例，2023 年 9 月 21 日，欧洲《芯片法案》正式生效，欧盟将投入超过 430 亿欧元资金，以提振欧洲芯片产业，法案要求欧盟芯片产量占全球的份额应从 2023 年的 10%提高至 2030 年的 20%，以满足自身和世界市场需求。

#### （2）集成电路全产业国产替代需求显著

集成电路对我国信息产业的发展至关重要。我国虽然是全球最大的芯片市场，但却长期依赖进口，在全球的芯片产业中也处于弱势的地位，尤其近些年外国断供以来，导致中国市场受到很大影响，加快发展自有核心技术、提高芯片的自给率已经迫在眉睫。国务院发布《中国制造 2025》提出 2025 年中国芯片自给率要达到 70%的发展目标，根据 TechInsights 的数据，2023 年中国芯片自给率不足 30%。为了实现产业的自主可控，集成电路作为国家战略性新兴产业有望得到政策大力扶持，产业、资本环境持续完善。

同时，随着全球终端制造和半导体制造重心向亚太地区转移，电源管理芯片设计领域也呈现出从欧美等地区向中国转移的趋势。多重因素相互作用下，越来越多的中国 OEM/ODM 厂商在缺货情况下开始选择本地供应商作为二级供应商，集成电路国产化需求显著提升。

具体在电源管理芯片领域，本土电源管理芯片设计企业在中美贸易摩擦持续升级的背景下加快了技术追赶，整体技术水平和国外设计公司的差距不断缩小，国内企业设计开发的电源管理芯片在多个应用领域，尤其是中小功率段的消费电子市场已经逐渐取代国外竞争对手的份额，出货量逐年攀升，市占率也逐步提高。

### 4、新模式

#### （1）产业链协同更为紧密

受宏观政治与经济局势的不确定性，以及中美贸易摩擦的影响，全球集成电路产业竞争加剧，

产业协同成为趋势。随着国际芯片巨头“军备竞赛”日益激烈，集成电路行业企业核心竞争力不再只是单项优势技术或产品，同样也来自于对产业链上高度集中、高效流动的资源掌控力和运营力，产业竞争模式已正式向“全产业链竞争”转变。

产业链协同发展有利于行业更快进步。芯片设计厂商与上游晶圆厂商、封测厂商及下游终端厂商协同更为紧密，构筑产业链上下游全方位的半导体生态体系更为重要。通过与下游终端厂商的协同以便更好地了解终端需求，从而指导研发方向；通过与上游晶圆厂商、封测厂商协同从而强化供应链能力以及共同推动晶圆制造、封测环节的技术进步。

在行业产业链协同发展过程中，行业竞争将更侧重产品、客户、人才综合实力的竞争，产业竞争模式朝着系统化和生态化发展。

### 3 公司主要会计数据和财务指标

#### 3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2023年	2022年		本年比上年 增减(%)	2021年
		调整后	调整前		
总资产	4,461,859,875.30	2,304,329,977.95	2,304,320,038.06	93.63	1,060,309,282.06
归属于上市公司股东的净资产	3,699,036,849.77	1,074,254,963.73	1,074,245,023.84	244.34	913,804,973.50
营业收入	1,780,402,270.59	1,300,780,807.00	1,300,780,807.00	36.87	984,172,727.72
归属于上市公司股东的净利润	261,357,464.90	246,210,346.95	246,200,407.06	6.15	244,030,087.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	251,140,676.92	235,714,735.16	235,704,795.27	6.54	236,696,203.66
经营活动产生的现金流量净额	208,167,251.04	349,912,394.38	349,912,394.38	-40.51	-82,536,338.96
加权平均净资产收益率(%)	8.77	25.63	25.63	减少16.86 个百分点	38.72
基本每股收益(元/股)	0.64	0.68	0.68	-5.88	0.71
稀释每股收益(元/股)	0.63	0.68	0.68	-7.35	0.71
研发投入占营业收入的比例(%)	16.43	14.32	14.32	增加2.11 个百分点	9.51

#### 3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	285,668,200.45	374,791,456.64	545,396,447.37	574,546,166.13
归属于上市公司股东的净利	30,958,612.32	69,673,660.05	79,574,265.49	81,150,927.04

润				
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	30,619,938.29	65,992,457.35	79,201,415.32	75,326,865.96
经营活动产生的现金流量净额	-24,765,447.47	189,964,637.47	-76,119,827.39	119,087,888.43

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

#### 4 股东情况

##### 4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)		13,452						
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)		13,206						
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）		不适用						
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）		不适用						
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数（户）		不适用						
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数（户）		不适用						
前十名股东持股情况								
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股 数量	比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	包 含 转 融 借 出 份 限 股 数	质押、标记或 冻结情况		股东 性质
						股份 状态	数量	
阮晨杰	0	72,780,573	17.18	72,780,573		无	0	境内 自然 人
上海辰木信息技术 合伙企业（有限合 伙）	0	51,390,183	12.13	51,390,183		无	0	其他
上海集成电路产业 投资基金股份有限 公司	0	24,778,189	5.85	24,778,189		无	0	国 有 法人
深圳市红杉瀚辰股 权投资合伙企业(有 限合伙)	0	23,578,920	5.57	23,578,920		无	0	其他

拉萨经济技术开发区顺为资本投资咨询有限公司—杭州顺赢股权投资合伙企业（有限合伙）	0	20,181,390	4.77	20,181,390		无	0	其他	
上海晨晖创业投资管理有限公司—上海浦软晨汇创业投资中心（有限合伙）	0	19,552,708	4.62	19,552,708		无	0	其他	
安克创新科技股份有限公司	0	18,910,720	4.47	18,910,720		无	0	境内非 国有法人	
OPPO 广东移动通信有限公司	0	15,004,577	3.54	15,004,577		无	0	境内非 国有法人	
维沃移动通信有限公司	0	12,468,350	2.94	12,468,350		无	0	境内非 国有法人	
英特尔亚太研发有限公司	0	12,003,661	2.83	12,003,661		无	0	境内非 国有法人	
上述股东关联关系或一致行动的说明				公司实际控制人阮晨杰先生为上海辰木信息技术合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明				无					

**存托凭证持有人情况**

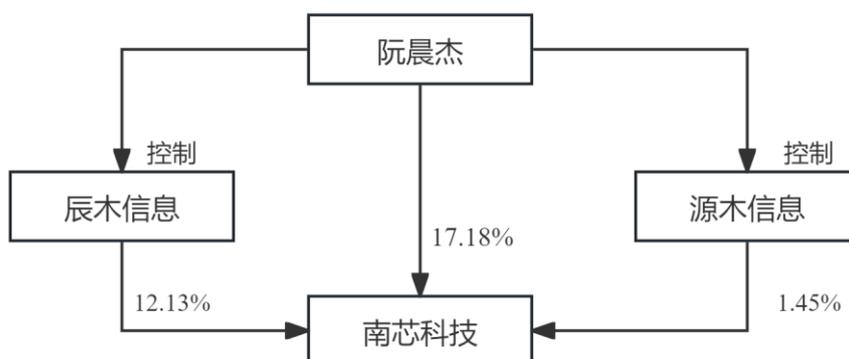
适用 不适用

**截至报告期末表决权数量前十名股东情况表**

适用 不适用

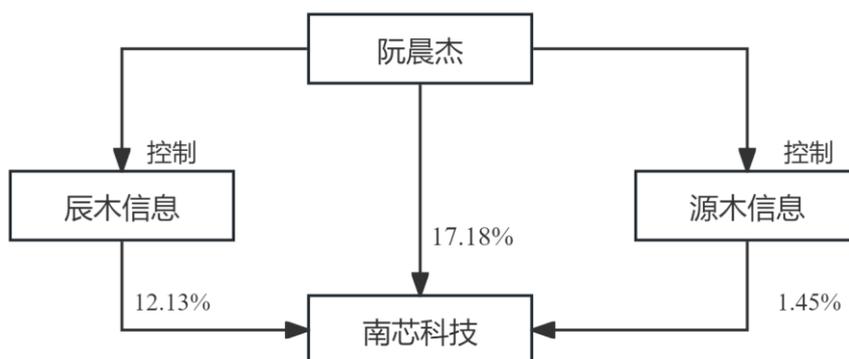
#### 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



#### 4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



#### 4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

适用 不适用

#### 5 公司债券情况

适用 不适用

### 第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2023 年度，公司实现营业收入 178,040.23 万元，同比增加 36.87%；营业利润 26,269.37 万元，同比增加 10.21%；利润总额 26,627.78 万元，同比增加 10.34%；归属于母公司所有者的净利润 26,135.75 万元，同比增加 6.15%。

报告期内，公司营业总收入同比增加 47,962.15 万元，增幅 36.87%，主要系业务规模扩大、销售额增长所致。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

适用 不适用